

| | | |
|---|--|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20250-6-2025</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Gennaio 2025 11:30:16</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|--|-----------------------|

Societa' : TECHNOPROBE

Identificativo Informazione Regolamentata : 200332

Utenza - Referente : TECHNOPROBEN04 - Di Terlizzi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Gennaio 2025 11:30:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Gennaio 2025 11:30:16

Oggetto : Nomina di Joseph Partks a Chief Technology Officer

Testo del comunicato

Vedi allegato



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

COMUNICATO STAMPA

Cambio al vertice della divisione tecnologica: Joseph Parks nominato Chief Technology Officer, un passaggio nel segno della continuità e dell'innovazione.

Cernusco Lombardone (LC), 14 gennaio 2025 –Technoprobe S.p.A. (EXM:TPRO), *leader* nella progettazione e produzione di Probe Card (la “Società” o “Technoprobe”) annuncia oggi la nomina di **Joseph Parks** a Chief Technology Officer a seguito delle dimissioni dal ruolo di **Fabio Morgana**, che intraprenderà nuove opportunità professionali.

Le dimissioni avranno efficacia a decorrere dal giorno 1 Aprile 2025: sino a tale data Fabio Morgana, continuerà a ricoprire gli attuali incarichi al fine di assicurare un'agevole transizione.

Joseph Parks, che ricopre attualmente il ruolo di Senior Vice President Technology Ambassador, porta con sé una vasta esperienza nel campo dei semiconduttori ed una profonda conoscenza del mercato di riferimento. La scelta strategica di mantenere una leadership interna garantisce piena continuità nei progetti in corso ed al contempo introduce una nuova visione nella gestione delle attività di ricerca e sviluppo.

Con un *Ph.D in Electrical and Computer Engineering* e un percorso in Intel Corporation di quasi 30 anni, Joseph Parks ha ricoperto nella sua carriera ruoli rilevanti e strategici: in qualità di *Vice President of Technology Development e Director dell'Oregon Assembly Test Development Factory* di Intel si è occupato di sviluppare tecnologie all'avanguardia nell'ambito del testing e dell'*Advanced Packaging*, incluse le *enhanced test thermal solutions* legate al *Singulated Die Test*, di particolare rilievo nel segmento dell'Intelligenza Artificiale.

“Siamo grati a Fabio per il suo significativo contributo allo sviluppo tecnologico dell'azienda ed alla costruzione della sua leadership. Ringraziandolo per l'impegno profuso, gli auguriamo il meglio per le sue future opportunità professionali.” ha dichiarato Stefano Felici, CEO di Technoprobe. *“La nomina di Joe conferma la valenza strategica della divisione Technology quale motore della crescita, che preserviamo attraverso la valorizzazione di professionalità già presenti all'interno del Gruppo. L'expertise di Joe nel segmento dell'intelligenza artificiale coniugata con la visione strategica di Technoprobe, saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente la nostra offerta e rispondere alle sfide future del settore.”*

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e di continuare a lavorare con un team straordinario,” ha dichiarato Joseph Parks. *“Il nostro lavoro sarà indirizzato al mantenimento della posizione di leadership della nostra azienda ed alla sua crescita in nuovi segmenti di mercato al fine di creare ancora più valore per i nostri clienti.”*

Alla data odierna Fabio Morgana detiene n.1.500 azioni della Società.

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale di € 6.532.608,70 - R.E.A. 283619

All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.



Technoprobe S.p.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
23870, Cernusco Lombardone (LC) - Italy
www.technoprobe.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito di Technoprobe, nella sezione **Investor Relations** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “**eMarket Storage**” (www.emarketstorage.it).

Contatti

Technoprobe S.p.A.

Investor Relator
Ines Di Terlizzi
Email: ir@technoprobe.com

Technoprobe S.p.A.

Communication & Marketing Manager
Paolo Cavallotti
Email: paolo.cavallotti@technoprobe.com

Gruppo Technoprobe

Technoprobe è un'azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Costituita nel 1996, Technoprobe è specializzata nella progettazione e realizzazione di interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card (schede sonda) per il test di funzionamento dei chip. Le Probe Cards sono dispositivi ad alta tecnologia - fatti su misura sullo specifico chip – che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione. Si tratta di progetti e soluzioni tecnologiche che garantiscono il funzionamento e l'affidabilità dei dispositivi che hanno un ruolo determinante nell'industria dell'Information Technology, del 5G, dell'Internet of Things, della domotica, dell'automotive, dell'aerospaziale. Technoprobe ha il suo headquarter in Italia, a Cernusco Lombardone (LC). Dal 2 maggio 2023, Technoprobe è quotata sul mercato Euronext Milan. Per maggiori informazioni: www.technoprobe.com

Technoprobe S.p.A. - Partita IVA e Codice Fiscale 02272540135 - Capitale Sociale di € 6.532.608,70 - R.E.A. 283619

All rights reserved. The COPYRIGHT of this document is property of TECHNOPROBE S.p.A. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form, whether wholly or in part, without a written consent. The contents or methods or techniques contained herein are CONFIDENTIAL, therefore must not be disclosed to any other person or company or entity.

Fine Comunicato n.20250-6-2025

Numero di Pagine: 4